1. **Communiqué de presse**

No. : REN2437(A)

**Renesas présente les premières solutions complètes de chipset d'interface mémoire de l'industrie pour les MRDIMM de serveur DDR5 de seconde génération**

*Le nouveau pilote d'horloge enregistrée multiplexée, le tampon de données multiplexé et le PMIC permettent aux MRDIMM de prochaine génération d'atteindre des vitesses de 12 800 méga transferts par seconde pour les applications d'intelligence artificielle et de calcul haute performance*

**Düsseldorf, le 20 novembre 2024 –** Renesas Electronics Corporation (TSE : 6723), fournisseur de premier plan de solutions de semi-conducteurs avancés, a annoncé aujourd'hui avoir livré les premières solutions complètes de chipset d'interface mémoire de l'industrie pour les modules de mémoire double en ligne à rangs multiples DDR5 de deuxième génération (MRDIMM).

Les nouveaux MRDIMM DDR5 sont nécessaires pour répondre à la demande croissante de bande passante mémoire des applications d'intelligence artificielle (IA), de calcul haute performance (HPC) et d'autres applications de centres de données. Ils offrent des vitesses de fonctionnement allant jusqu'à 12 800 méga transferts par seconde (MT/s), soit une amélioration de 1,35 fois la bande passante de la mémoire par rapport aux solutions de première génération. Renesas a joué un rôle déterminant dans la conception, le développement et le déploiement des nouveaux MRDIMM, en collaborant avec les leaders de l'industrie, notamment les fournisseurs de processeurs et de mémoires, ainsi qu'avec les clients finaux.

Renesas a conçu et exécuté trois nouveaux composants critiques : le pilote d'horloge enregistrée multiplexée (MRCD) de deuxième génération RRG50120, le tampon de données multiplexées (MDB) de deuxième génération RRG51020 et le circuit intégré de gestion d'énergie (PMIC) de deuxième génération RRG53220. Renesas propose également des solutions de capteurs de température (TS) et de concentrateurs de détection de présence en série (SPD) en production de masse, ce qui en fait la seule société d'interface mémoire à proposer des solutions de chipset complètes pour les MRDIMM au standard industriel de prochaine génération ainsi que pour tous les autres DIMM de serveurs et de clients.

« La demande de systèmes plus performants, conduite par les applications d'IA et de HPC est sans limite », a déclaré **Davin Lee, vice-président senior et directeur général d'Analog & Connectivity et Embedded Processing**. « Renesas est à l'avant-garde de cette tendance, travaillant avec les leaders de l'industrie pour développer la technologie et les spécifications de la prochaine génération. Ces entreprises comptent sur Renesas pour leur apporter le savoir-faire technique et les capacités de production dont elles ont besoin pour répondre à une demande sans précédent. Nos dernières solutions de chipset pour les MRDIMM DDR5 de deuxième génération démontrent notre leadership sur ce marché. »

Le MRCD de deuxième génération RRG50120 de Renesas est utilisé sur les MRDIMM pour mettre en mémoire tampon le bus de commande/adresse (CA), les sélections de puce et les horloges entre le contrôleur hôte et les DRAM. Il consomme 45 % d'énergie en moins par rapport aux composants de première génération, une spécification essentielle pour la gestion de la chaleur dans les systèmes à très grande vitesse. Le MDB RRG51020 Gen2 est l'autre composant clé utilisé dans les MRDIMM pour mettre en mémoire tampon les données entre le CPU hôte et les DRAM. Les nouveaux MRCD et MDB de Renesas prennent en charge des vitesses allant jusqu'à 12,8 gigaoctets par seconde (Gbps). En outre, le PMIC de prochaine génération RRG53220 de Renesas offre la meilleure protection contre les surcharges électriques de sa catégorie, une efficacité énergétique supérieure et est optimisé pour un fonctionnement à courant élevé et à basse tension.

**Disponibilité**

Renesas échantillonne actuellement le RRG50120 MRCD, le RRG51020 MDB et le RRG53220 PMIC, et prévoit que ces nouveaux produits seront disponibles pour la production au cours du premier semestre 2025. De plus amples informations sur ces nouveaux produits sont disponibles sur le site [renesas.com/DDR5](https://www.renesas.com/en/products/memory-logic/memory-interface-products/ddr5-solutions?utm_campaign=mid_mrdimm-&utm_medium=pr&creative=pr&utm_content=lp&type=pron).

**À propos de Renesas Electronics Corporation**

Renesas Electronics Corporation ([TSE: 6723](http://www.jpx.co.jp/english/)) offre un avenir plus sûr, plus intelligent et plus durable où la technologie nous facilite la vie. L'un des principaux fournisseurs mondiaux de microcontrôleurs, Renesas combine notre expertise dans le traitement embarqué, l'analogique, l'alimentation et la connectivité pour fournir des solutions complètes de semi-conducteurs. Ces combinaisons gagnantes accélèrent la mise sur le marché des applications automobiles, industrielles, d'infrastructure et IoT, permettant à des milliards d'appareils connectés et intelligents d'améliorer la façon dont les gens travaillent et vivent. En savoir plus sur [renesas.com](http://www.renesas.com/). Suivez-nous sur [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/renesas/), [Facebook](https://www.facebook.com/RenesasElectronics/), [X](https://twitter.com/renesasglobal), [YouTube](https://www.youtube.com/user/RenesasPresents) et [Instagram](https://www.instagram.com/renesas_global/).

###

(Remarques) Tous les noms de produits ou de services mentionnés dans ce communiqué de presse sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

**Contact médias :**

Alexandra Janetzko

HBI Communication Helga Bailey GmbH (PR agency)

Tel.: +49 89 99 38 87-32

Email: alexandra\_janetzko@hbi.de

Web: [www.hbi.de](http://www.hbi.de/)